

Spring back performance
スプリングバック性

Dimensional stability
寸法安定性

High heat resistance
高耐熱

Proposals 提案

- Thin flexible circuit board materials with a low modulus polyimide
- Excellent Spring back performance and high flexibility
- Excellent dimensional stability
- Excellent flex resistance
- Halogen-free (Adhesiveless)

- 低弾性ポリイミド層の薄物フレキシブル基板材料
- 優れたスプリングバック性とほぜ折り性
- 優れた寸法安定性
- 優れた耐屈曲性
- ハロゲンフリー(接着剤未使用)

Applications 用途

Smartphone (Casing edge, Slide keyboard),
DSCs (Camera module), LCD module, Automotive components, etc.

スマートフォン(筐体エッジ部分、スライドキーボード)、
デジタルカメラ(カメラモジュール)、LCDモジュール、
車載機器など

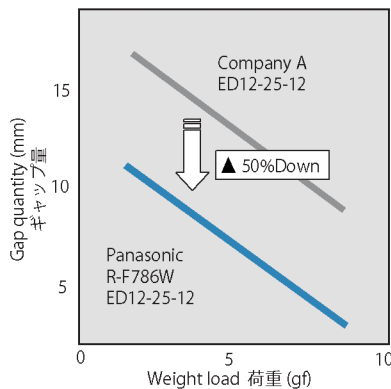
Solder heat resistance はんだ耐熱性

Solder temp (°C) はんだ温度	High heat resistance type 高耐熱タイプ R-F786W	Standard type スタンダードタイプ R-F775
Normal state 常態	360	330
After absorption 吸湿後 40°C 90% 96Hr	300	270

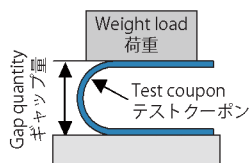
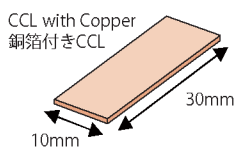
General properties 一般特性

Item 項目	Test method 試験方法	Condition 条件	Unit 単位	High heat resistance type 高耐熱タイプ R-F786W	Standard type スタンダードタイプ R-F775	Standard Value 標準値
Solder heat resistance はんだ耐熱性	JIS C6471	288°C solder float for 1min はんだフロート288°C1分	-	No abnormality 異常なし	No abnormality 異常なし	No abnormality 異常なし
Moisture absorption 吸湿はんだ耐熱性	Internal method 社内法	C-96/40/90 260°C solder float for 1min はんだフロート260°C1分	-	No abnormality 異常なし	No abnormality 異常なし	No abnormality 異常なし
Dielectric constant(Dk) 比誘電率	1MHz IPC TM-650 2.5.5.5	A	-	3.2	3.2	4.0 (max)
Dissipation factor(Df) 誘電正接				0.008	0.002	0.07 or less
Tensile modulus 弾性率	ASTM D882	A	GPa	5.1	7.1	-
Surface resistivity 表面抵抗	JIS C6471	A	Ω	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵	1×10 ¹¹ or more
Peel strength 銅箔引き剥がし強さ	1/2oz IPC TM-650 2.4.9	A 260°C solder float for 5sec はんだフロート260°C5秒	N/mm	1.1	1.3	0.525 or more
				1.2	1.3	0.525 or more
Chemical resistance 耐薬品性	JIS C6471	HCL 2mol/l 23°C 5min NaOH 2mol/l 23°C 5min IPA 23°C 5min	-	No abnormality 異常なし	No abnormality 異常なし	No abnormality 異常なし
Dimensional stability 寸法安定性	IPC TM-650 2.2.4	After etching MD エッチング後タテ方向	%	0.021	0.030	0.10~0.10
		After etching TD エッチング後ヨコ方向		0.015	0.037	0.10~0.10
		After E-0.5/150 MD E-0.5/150後タテ方向		0.018	0.022	0.10~0.10
		After E-0.5/150 TD E-0.5/150後ヨコ方向		0.015	0.027	0.10~0.10
Flammability 耐燃性	UL	A + E-169/70	-	94VTM-0	94V-0	94V-0

Spring back performance スプリングバック性



● Condition
試験条件



The sample thickness is 0.025mm 試験片の厚さは0.025mmです。

The above data is actual values and not guaranteed values. 上記データは実際の実測値であり、保証値ではありません。

More Product line from Panasonic 関連商品

- Functional liquid encapsulant ECOM Fine Flow Series
- For mobile products flexible circuit board materials
- For automotive components and mobile product halogen-free multi-layer materials

Please see the page for "Notes before you use" 商品のご採用に当たっての注意事項はこちら

- 高機能液状封止材 ECOM Fine Flowシリーズ
- モバイル機器向けフレキシブル基板材料 FELIOSシリーズ
- 車載機器・モバイル機器向けハロゲンフリー多層基板材料

page 18
page 42
page 48